

2026年3月期 第3四半期決算説明会 レポート

東京精密（7729） - 生成AI/HPC需要を背景に最高益更新基調、割安感際立つ



発行日：2026年2月
対象：機関投資家向け決算分析

エグゼクティブ・サマリー：AI恩恵と割安なバリュエーション



業績 (Performance)



第3四半期累計の売上高は既往ピークを更新。生成AI/HPC向けが牽引し、前年同期比で増収増益（売上+9.5%、営業利益+9.7%）を達成。



見通し (Outlook)



通期業績予想を上方修正（売上1,650億円、営業利益320億円）。第4四半期にDDR5/NAND等の出荷増を見込み、保守的な為替想定（140円/\$）もあり上振れ余地が大きい。



中計 (Mid-Term Plan)



28/3期目標（売上1,850億円、営業利益450億円）に対し、CEOは「十分達成可能」との自信を示す HBM4やハイブリッドボンディング等の技術転換が追い風。



評価 (Valuation)



DISCOやTELと比較し、同様のAIテーマ性を持ちながらPERは割安水準。27/3期の収益伸長を考慮すると投資妙味は大。

26/3期 第3四半期決算：HPC需要を背景に売上・営業利益は増益基調

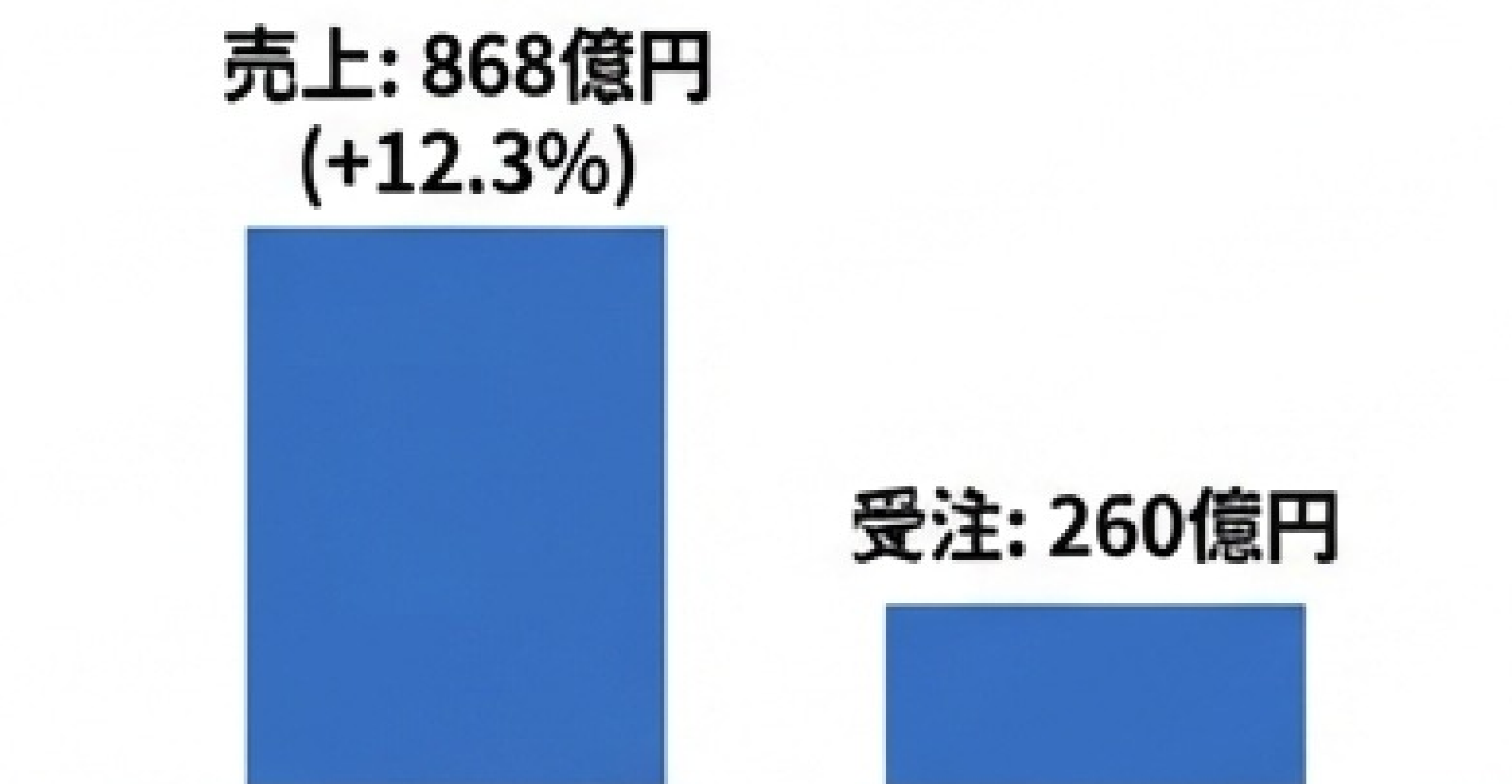
項目	金額 (百万円)	前年同期比
売上高	1,129	+9.5%
営業利益	209	+9.7%
経常利益	217	+9.7%
四半期純利益	141	-21.9%

- 半導体製造装置（SPE）と計測機器の両セグメントが計画通りに進捗。
- 営業利益率は19%を維持。部材費・人件費の高騰を増収効果とミックス改善（高付加価値製品の増加）で吸収。

※第2四半期の製品不具合対策費（特損）計上の影響

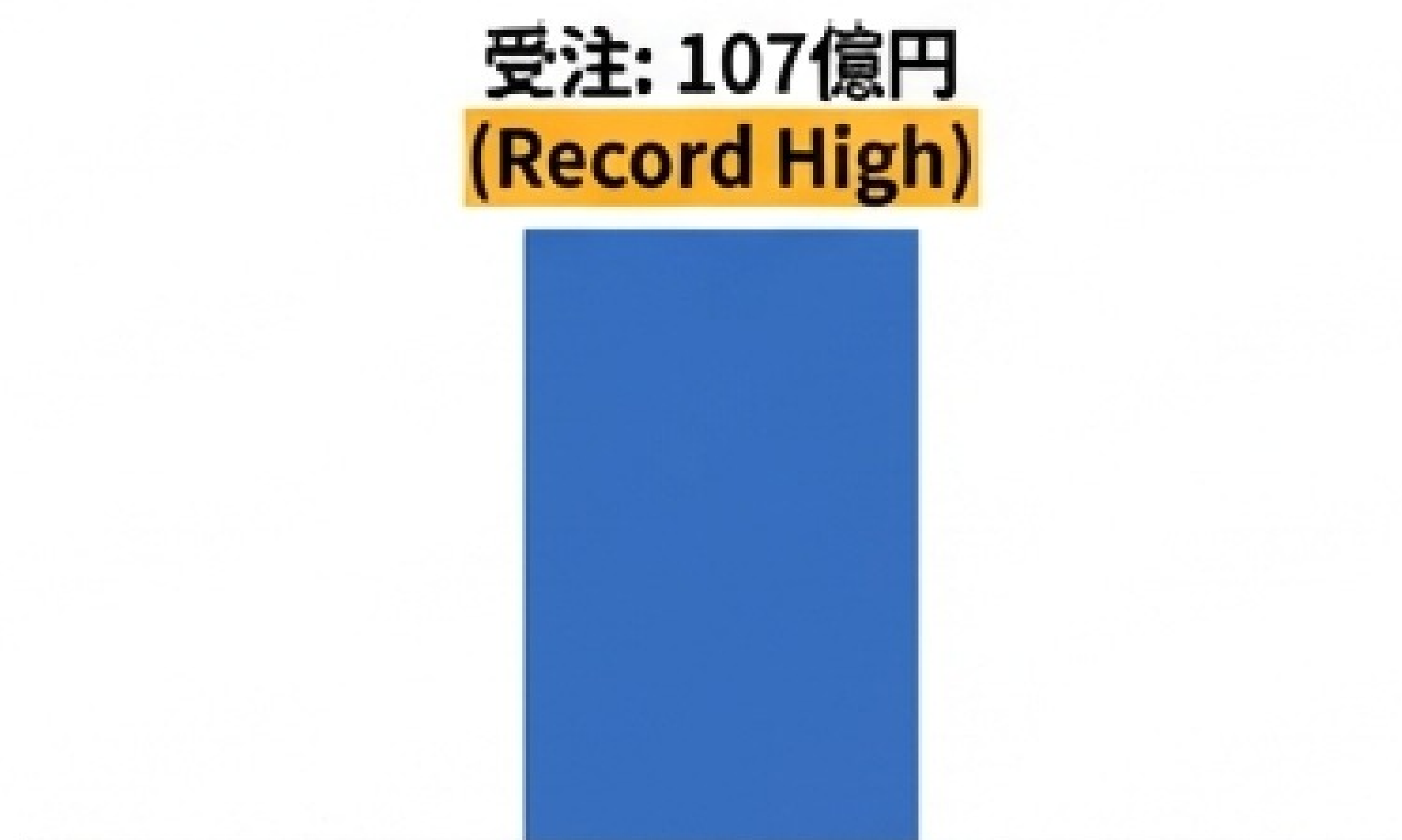
セグメント別分析：SPEは想定内の受注変動、計測は航空宇宙・防衛で最高水準

半導体製造装置（Semiconductor SPE）



- 第2四半期に大型HBM案件があった反動減だが、会社計画線内で着地。
- HBM案件は「波（Lumpiness）」があるが、生成AI/HPC需要の基調は変わらず。
- 第4四半期に再び受注増を見込む。

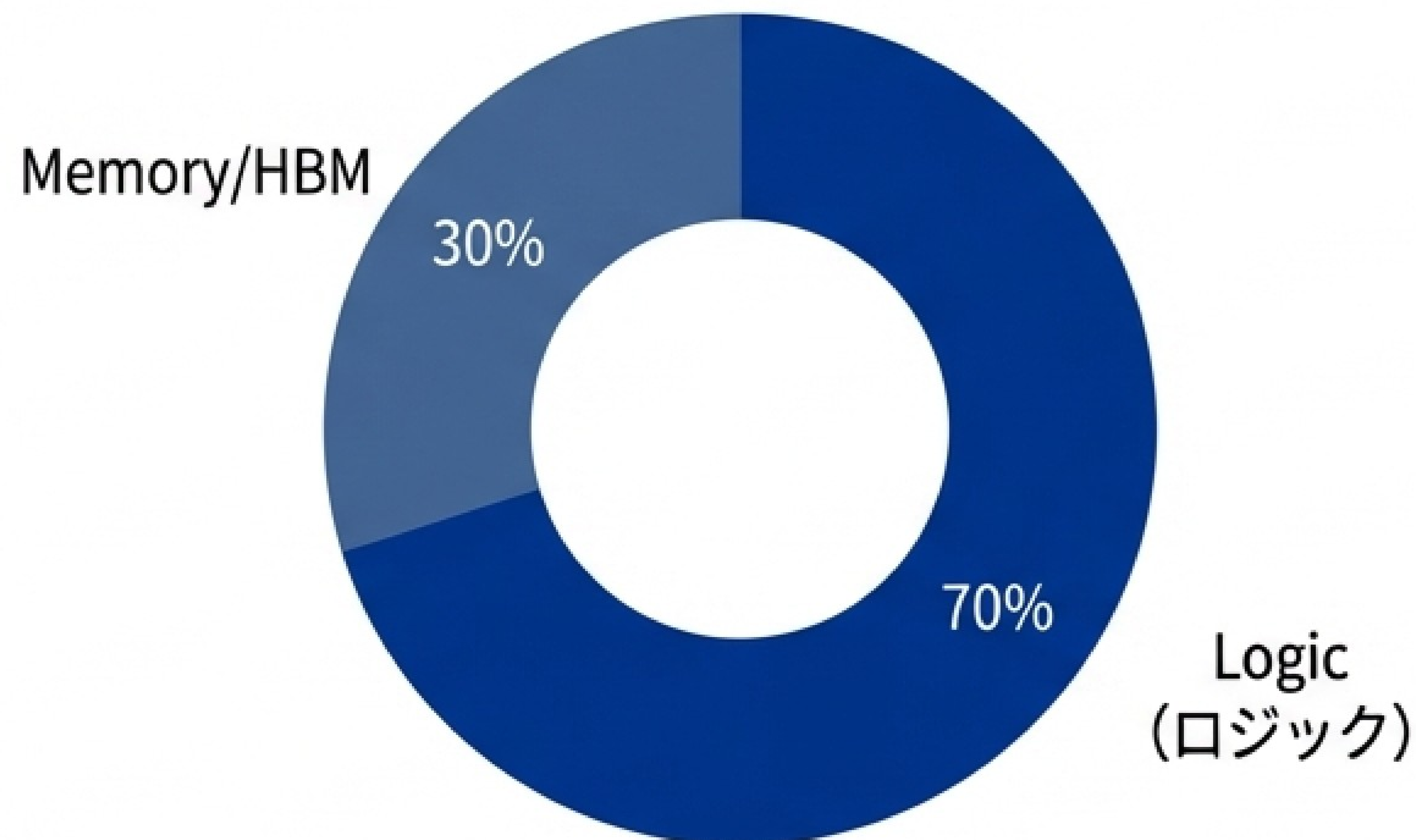
計測機器（Metrology）



- 受注高は四半期既往ピークを更新。
- 自動車・産機向けが停滞する中、航空・宇宙・防衛分野およびハイブリッド車（HEV）関連の新規需要が拡大。
- 安定収益源としての底力を発揮。

ユーザー・アプリケーション分析：ロジック・HBMが牽引、中国はハイエンドへシフト

Application Mix



生成AI/HPC

- 売上・利益の約4割を占める重要ドライバー。

Logic vs Memory

- 受注残における比率は直近でロジック優勢（約7割）へシフトしたが、第4四半期以降はDRAM/HBM（メモリ）の復調により構成比が変化する見込み。

HBM (High Bandwidth Memory)

- 第2四半期に大型受注、第3四半期は一服したが、**第4四半期に再び波が来る想定。**

中国市場

- 汎用的なレガシー投資から、HPCを含むハイエンド装置へのシフトが鮮明。需要は底堅い。

Precision Analyst Note

通期業績予想の上方修正：第4四半期の出荷増と保守的な前提

項目	修正予想	前回予想比	前年比
売上高	1,650億円	+10億円	+9.6%
営業利益	320億円	+5億円	+7.7%

上振れの可能性 (Upside Potential)

- 1. **出荷集中**: DDR5、NAND向けなど、第4四半期に検収・出荷が集中する見込み。
- 2. **為替レート**: 前提レートは1ドル=140円に据え置き。実勢レート（円安水準）がかけ離れており、為替差益による上振れ余地あり。
- 3. **利益率改善**: 第4四半期は売上増に伴う操業度向上と、高付加価値製品（高精度プローバ等）の比率上昇により、利益率が大きく改善する構造。

中期経営計画（28/3期）の蓋然性：受注環境を背景に「十分達成可能」

FY2028/3 目標：売上1,850億円 / 営業利益 450億円 (OPM 24%)

AI/HPCの拡大

市場成長に沿った自然増収。CEOは「足元の受注環境を前提とすれば十分視野に入っている」とコメント。

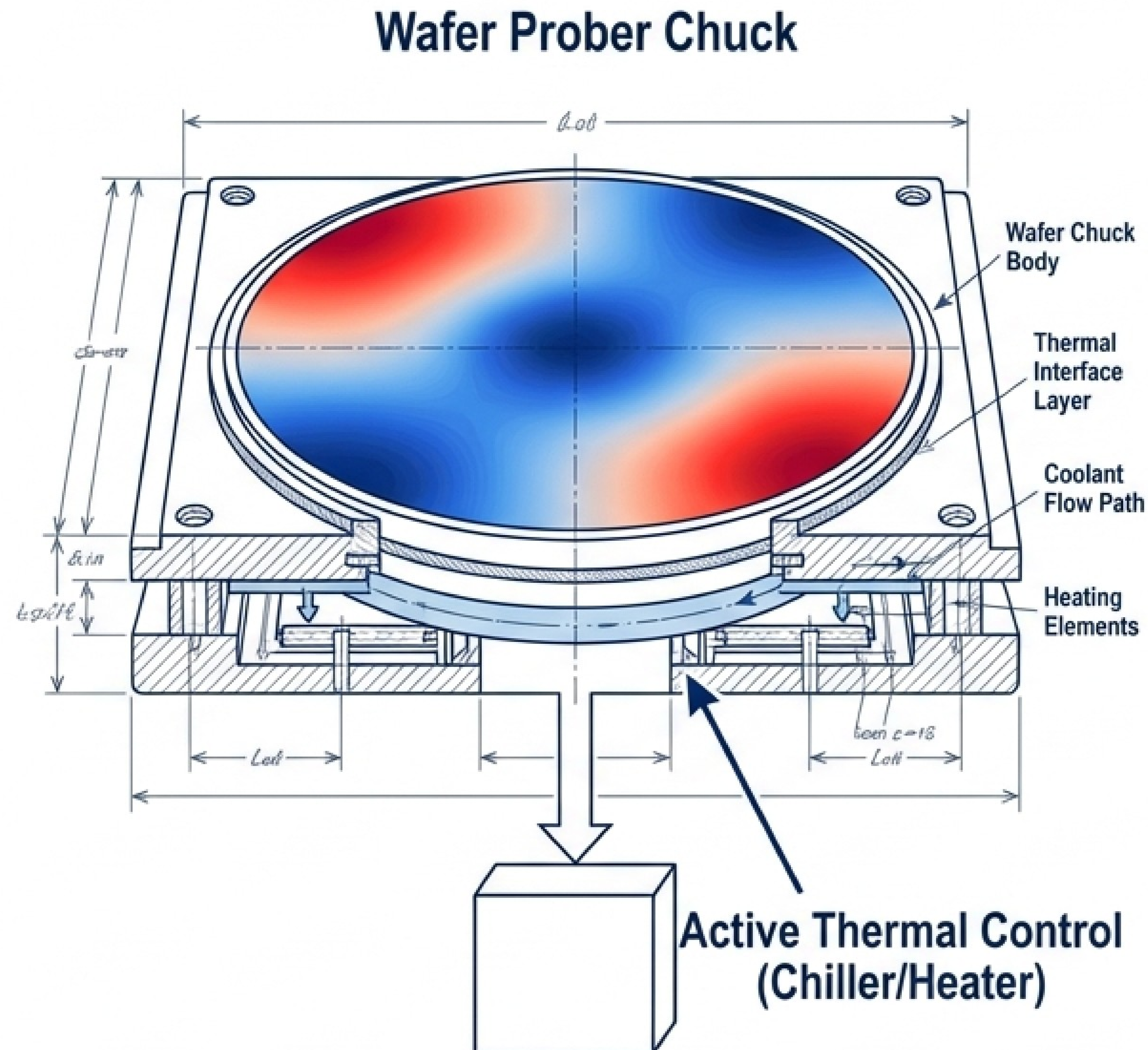
新技術の貢献

ハイブリッドボンディング (Hybrid Bonding) 向け装置が26/3期下期から受注貢献開始。27/3期以降に本格化。

収益性向上

HBM4など難易度の高いプロセスへの移行が単価・利益率を押し上げる。
OPM 24%への道筋は明確。

技術競争優位性①：先端半導体（HBM/Logic）における「温度制御技術」



The Challenge (課題)

HBMやハイエンドLogicのテスト工程（バーンイン/ファイナルテスト）では、デバイス自体が自己発熱し、膨大な熱を持つ。熱膨張によるコンタクト不良を防ぐため、極めて精密な温度制御が不可欠。

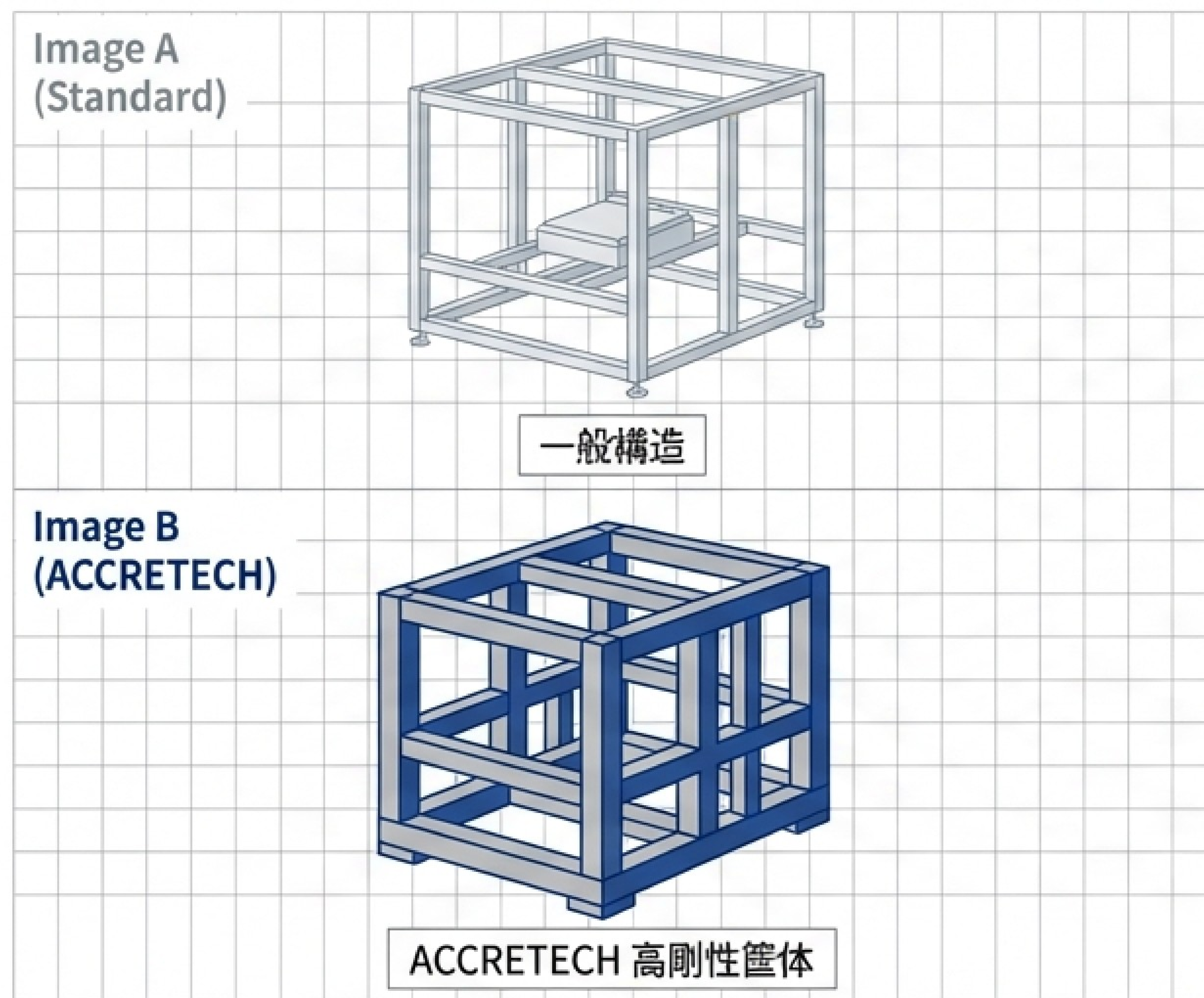
ACCRETECH's Solution

- **アクティブ熱制御:** 自社製のチラー（冷却装置）とチャック（ウエハ台）を組み合わせた高度な温度制御システム。
- **広範囲・高速:** -40°C から $+150^{\circ}\text{C}$ といった過酷な温度サイクル下でも高い安定性を維持。

Impact:

この技術的障壁（Moat）により、HBM向けプローバ市場での高シェア・高利益率を維持。

技術競争優位性②：パワー半導体 (SiC) における「剛性」と「特許」



SiC (炭化ケイ素) のような難削材加工には、圧倒的な筐体剛性が不可欠。

対DISCO競争力 (vs Competitors)

市場の巨人であるディスコに対し、東京精密は着実にシェアを獲得中。

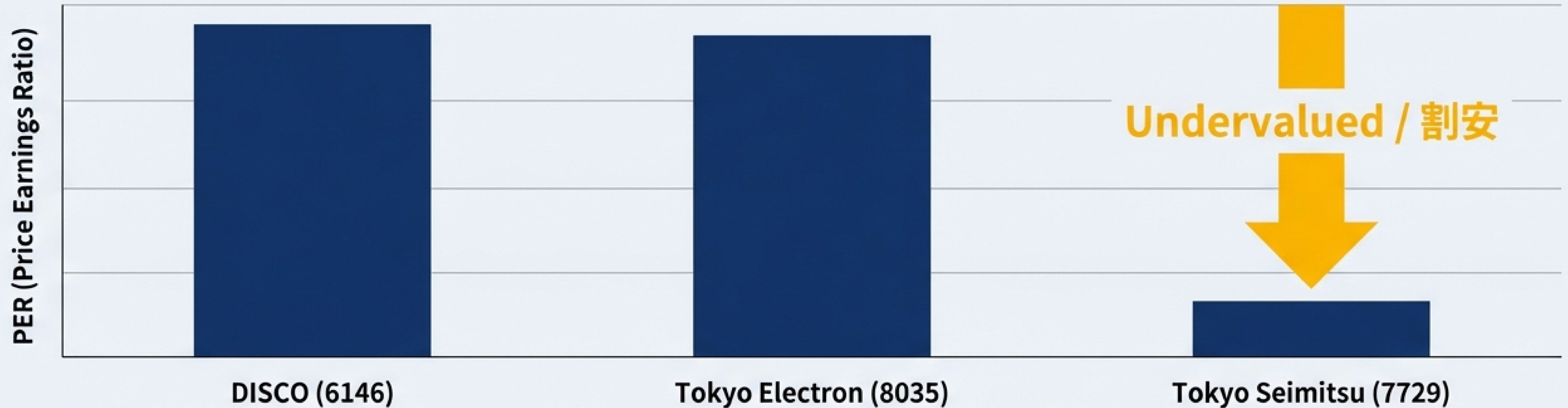
Winning Factors

1. **高剛性筐体 (High Rigidity)**: 独自の筐体設計により、加工時の負荷に耐え、TTV (厚みばらつき) を極小化。
2. **知的財産 (Patents)**: 独自の研削方式や搬送技術に関する特許網が、強力な参入障壁。

Conclusion

PMIC向けなどは復調傾向。SiCの12インチ化や難削材加工において、ディスコに対し「十分に戦える」技術的優位性を保持。

結論：セクター内での相対的な割安感と利益成長によるアップサイド



- **バリュエーション:** DISCOやTELが生成AI期待を織り込み高PERにある一方、東京精密は割安感が際立つ。
- **27/3期の飛躍:** 来期はHPC需要の本格寄与と利益率改善により、EPS成長率がセクター平均を上回る公算大。
- **中計達成の可視化:** 売上1,850億円・営業利益450億円が視野に入り、株価の切り上げ（Re-rating）が期待される。

Rating: Positive 継続